



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 18684

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2024 年第一季自結財務報告

2024 年 4 月 26 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(26)日公告 2024 年第一季自結財務報告。

2024 年第一季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 44.42 億元，較前季減少 8.7%，較去年同期增加 55%
- ◆ 本季合併毛利率為 22.4%，較前季減少 7 個百分點；
本季營業淨利率為 4.1%，較前季減少 9 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 1.84 億元，較前季減少 71%
- ◆ 本季歸屬於母公司淨利為新台幣 4.07 億元，前季為新台幣 3.85 億元；
本季每股盈餘為新台幣 0.96 元，前季為新台幣 0.91 元

2024 年第二季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第二季營收預計較前一季成長 low-teens 百分比。
- ◆ 第二季毛利率預計約為 mid-twenties 的水準。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“2024年第一季如之前預料的進入傳統淡季，合併營收為新台幣44.42億元，較前一季下滑8.7%，與去年同期相比則大幅成長55%，也略優於原先的預期。由於產能利用率自上一季的60%下滑到55%，以及產品組合的不利因素，加上受到合併子公司所持有的中國客戶上市股票本季股價波動影響，本季營業毛利率自上一季的29.4%下滑到22.4%，營業淨利率也因此自上一季的13.1%下滑到4.1%。第一季歸屬於母公司淨利為新台幣4.07億元，EPS為新台幣0.96元。

回顧第一季各項產品的營收變化中，Wi-Fi 在終端市場順利去化庫存之後營收成長最為顯著，而且是繼去年第二季之後首次恢復正成長。Cellular 則仍然延續去年下半年的動能不減，營收水準與前一季相當，以上二者本季都可以視為淡季不淡。至於Infra 營收金額一貫是上下幅度不大，本季則是略低於上一季的水準。最後，Optical 則是本季營收下滑最明顯的產品，主要是因為3D感測終端產品出貨旺季已過，加上今年終端客戶增加新供應商所致。

智慧型手機市場在過去遭遇了長達1年半的庫存調整，同時也歷經了高階手機的銷售不振，在手機差異性不大的情況之下，造成零組件供應商淪於殺價競爭的不健康現象。最近依據研究機構Counterpoint Research 最新發表的預測，2024年全球智慧型手機全年出貨成長率預估將為3%，年出貨量也將回升到12億支的水準，同時它們認為年成長率最高的將會是高階機種(Premium Segment)，年增率預估高達17%。而高階手機的特性一向是強調創新、注重品質及效能(performance)，有別於中低階手機總是優先考量價格而犧牲性能。而穩懋在高階智慧型手機市場一直有很高的市佔率，這是因為我們每年投入大量的研發經費，用以提供給客戶最先進、高效能的代工技術與服務，協助客戶打入高階市場，以提供客戶更高的附加價值為穩懋的策略及經營模式，因此我們樂見這樣的趨勢回歸，也期待未來的營收及獲利能因而受益。

展望2024第二季，預期在智慧型手機及Wi-Fi的需求帶動之下，營收將較前一季成長 low-teens 百分比，毛利率約為 mid-twenties 的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於1999年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋更以MMIC生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。